



## POPRAWA NIEZAWODNOŚCI BEZOŁOWIOWYCH POŁĄCZEŃ LUTOWANYCH W PAKIETACH ELEKTRONICZNYCH

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013  
Priorytet I. Badania i Rozwój Nowoczesnych Technologii  
Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe  
Poddziałanie 1.3.1. Projekty rozwojowe

### Koordinator projektu (Beneficjent):



Instytut Odlewnictwa (Koordinator)  
ul. Zakopiańska 73  
30-418 Kraków

### Pozostali Konsorcjanci:



Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN  
ul. Reymonta 25  
30-059 Kraków



**Fideltronik**

FIDELTRONIK Imel Spółka z o.o.  
ul. Beniowskiego 1  
34-200 Sucha Beskidzka

### Instytucje otrzymujące wsparcie finansowe:



Instytut  
Odlewnictwa



Instytut Metalurgii i  
Inżynierii Materiałowej PAN

### Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem bezpośrednim projektu jest realizacja dyrektyw UE w zakresie zakazu stosowania niebezpiecznych substancji w produktach elektronicznych na drodze poprawy niezawodności bezołowiowych połączeń lutowanych pakietów elektronicznych, wytwarzanych z wykorzystaniem przyjaznych dla środowiska nowej generacji lutów bezołowiowych, poprzez:

- systemowe i kompleksowe badania porównawcze właściwości różnego typu połączeń lutowanych wytwarzanych w skali laboratoryjnej i przemysłowej,
- zidentyfikowanie przyczyn utraty niezawodności połączeń,
- określenie wpływu charakterystyk materiałowych, parametrów technologicznych oraz innych zidentyfikowanych czynników na strukturę, fizyczne, mechaniczne i użytkowe właściwości różnego typu połączeń lutowanych,
- opracowanie/udoskonalenie procedury kontrolingu procesu lutowania i oceny jakości połączeń lutowanych,
- opracowanie rozwiązań materiałowo-technologiczno-konstrukcyjno-organizacyjnych zapewniających poprawę niezawodności połączeń pakietów elektronicznych.

